

06.10.2011 - 10:05 Uhr

ChipSiP gibt hochkarätige SiP Lösungen bekannt, die ein uneingeschränktes Sharing Life erlaubt

Taiwan (ots/PRNewswire) -

ChipSiP Technology Co, Ltd. (Taiwan: 3637), das führende Unternehmen für voll schlüsselfertige SiP Lösungen hat drei neue Produkte auf den Markt gebracht, die sich durch optimale Dünne, Tragbarkeit und Konnektivität für ein vernetztes Leben mit Cloudcomputing durch das integrierte Design von Logik, RF und schlüsselfertigen Lösungen auszeichnen. SiP bringt Verbrauchern ein smartes, vernetztes Leben mit der Möglichkeit, besondere Momente ihres Lebens ganz einfach über verbundene Geräte, wie Smartphones, Digitalkameras, Camcorder, Tablet-PCs und Fernsehgeräte zu teilen.

Feng Lai, der Vorsitzende von ChipSiP, kommentiert dies wie folgt: "Angesichts der steigenden Erwartungen an Multimediageräte wie Tablet-PCs und Smartphones bringen wir den 7-in-1 SiP mit der höchsten Dichte, den schlanksten Tablet-PC mit 9,85 mm und das leichteste WiDi der Welt, mit einem Gewicht von nur 90 Gramm auf den Markt. Zusätzlich zu dem Durchbruch bei der Multichip-Design-Technologie und den Geräteabmessungen haben wir erneut bewiesen, dass die ins tägliche Leben eingebettete SiP-Technologie lustig, einfach und spannend sein kann und, dass es die Verwendung dieser Multimedia-Anwendungen den Konsumenten dank der einfach zu verwendenden, smarten Geräte erlaubt, einen neuen Lebensstil anzunehmen."

Fortschrittliche SiP-Technologie reduziert die PCB-Grösse gegenüber gängigen Tablet-PCs um unglaubliche 80 %

ChipSiP setzt seine Grundwerte der Systemintegration und Designminiaturisierung ein, um einen Applikationsprozessor, 2 DDR3 Einheiten, 2 NAND Einheiten, WiFi und Bluetooth in einem 7-in-1 SiP erfolgreich zu kombinieren, der nur 18 x 18 mm misst. Dieses Design wird eine vollständig neue Ära mit leichteren und schlankeren Tablet-PCs und Smartphones einleiten.

ChipSiP gab ebenfalls ein verbessertes WiDi Design bekannt, sowie ein WiDi Dongle, das nur 90 Gramm wiegt und WiFi MIMO Technologie einschliesst, damit Multimedia-Inhalt wie Video, Fotos und Webseiten drahtlos von PCs, Tablet-PCs und Smartphones auf ein Fernsehgerät übertragen werden können.

ChipSiP entwickelt eine neue schlüsselfertige Tablet-PC-Lösung, die 9,85 mm schlank ist und eine Oberfläche von nur 47 mm² aufweist, um das Gewicht zu reduzieren, die Leistung zu erhöhen und die Energieeffizienz zu steigern. Die Kombination des miniaturisierten Memory SiP und RF SiP mit Android bietet Verbrauchern mehr Spass und Bedienerfreundlichkeit, da sie den Echtzeitaustausch jederzeit und überall ermöglicht. Zusätzlich wird ChipSiP im Q4 eine high-end Tablet-PC-Lösung mit einer CPU-Taktfrequenz von 1 GHz und mit 8,6 mm dem weltweit dünnsten Design herausbringen.

Medienkontakt: Fenny Chen Telefon: +886-2-8227-1799 Nst. 2101 E-Mail: fennychen@chipsip.com

Kontakt:

.

Diese Meldung kann unter <https://www.presseportal.ch/de/pm/100022064/100705321> abgerufen werden.